

テクニカルセミナー：実演

【日時】2018年2月27日(火) 16:00~17:00

【定員】40名 (事前申し込み制)

【場所】東京大学薬学部 W3 セミナー室 (西館3階)

口演：唯一の High Power レーザーマイクロダイセクションシステム LMD7

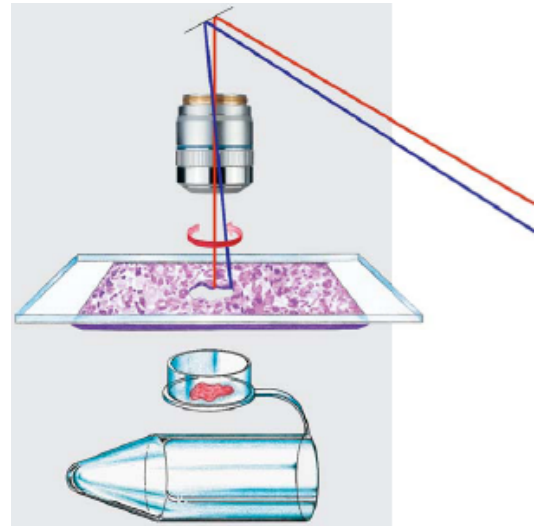
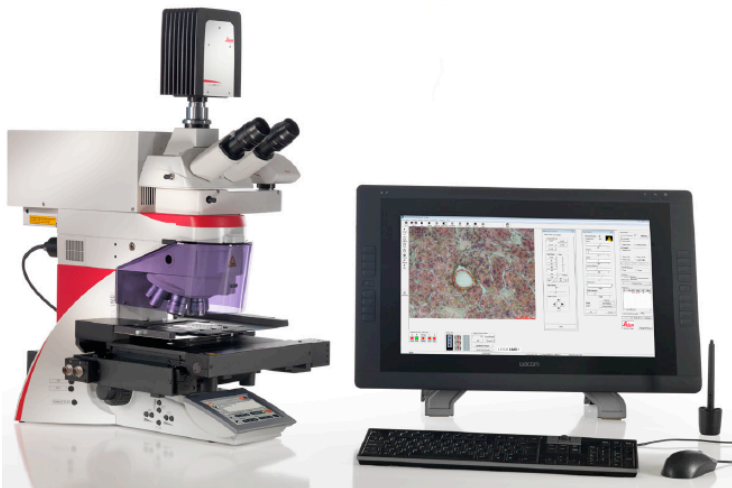
◆ DNA、RNA 解析からプロテオミクス、LC/MS バイオマーカー探索まで ◆

演者：ライカマイクロシステムズ株式会社 アプリケーション部 鶴巻 宣秀

【内容】

レーザーマイクロダイセクション（以下 LMD）は、標本を顕微鏡下で観察しながら形態に特徴のある領域のみをレーザービームで切断、回収する装置です。コンタミの無いサンプルから DNA、RNA、タンパク質抽出を行うことで、より正確で詳細な結果を得ることが出来ます。

登場してから約 17 年、進化してきた LMD7 は、世界唯一の High Power カットングレーザーを搭載しており、パラフィン包埋切片・凍結切片に加え、骨などの硬組織・培養細胞・蛍光標本まで様々な標本から単一細胞や細胞グループを迅速、高精度にコンタミネーションなく単離、回収することが可能になり実験の幅が広がりました。



設置機器

レーザーマイクロダイセクション システム Leica LMD7000

《349nm ハイパワー UVレーザーを唯一 標準搭載し、全自動正立顕微鏡との組み合わせでコンタミネーションフリーを実現!! 高精度のダイセクションをご確認ください。》

【申し込み】

ワンストップ創薬共用ファシリティーセンター

担当：渡辺 順子

Mail:watanabea@mol.f.u-tokyo.ac.jp

【問い合わせ】

ライカマイクロシステムズ株式会社

担当：石坂 信也

Mail:shinya.ishizaka@leica-microsystems.co.jp

TEL:080-8016-8700